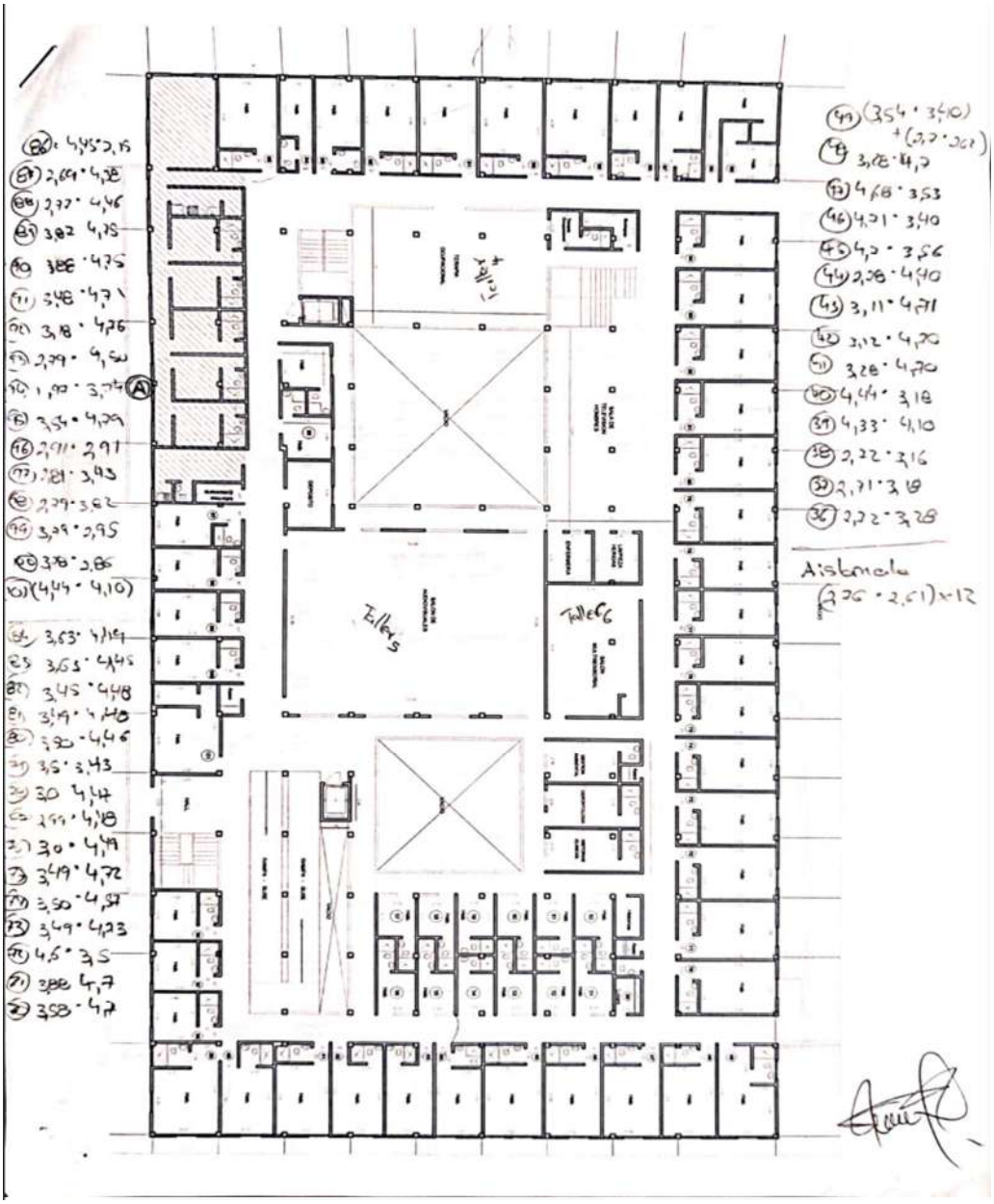
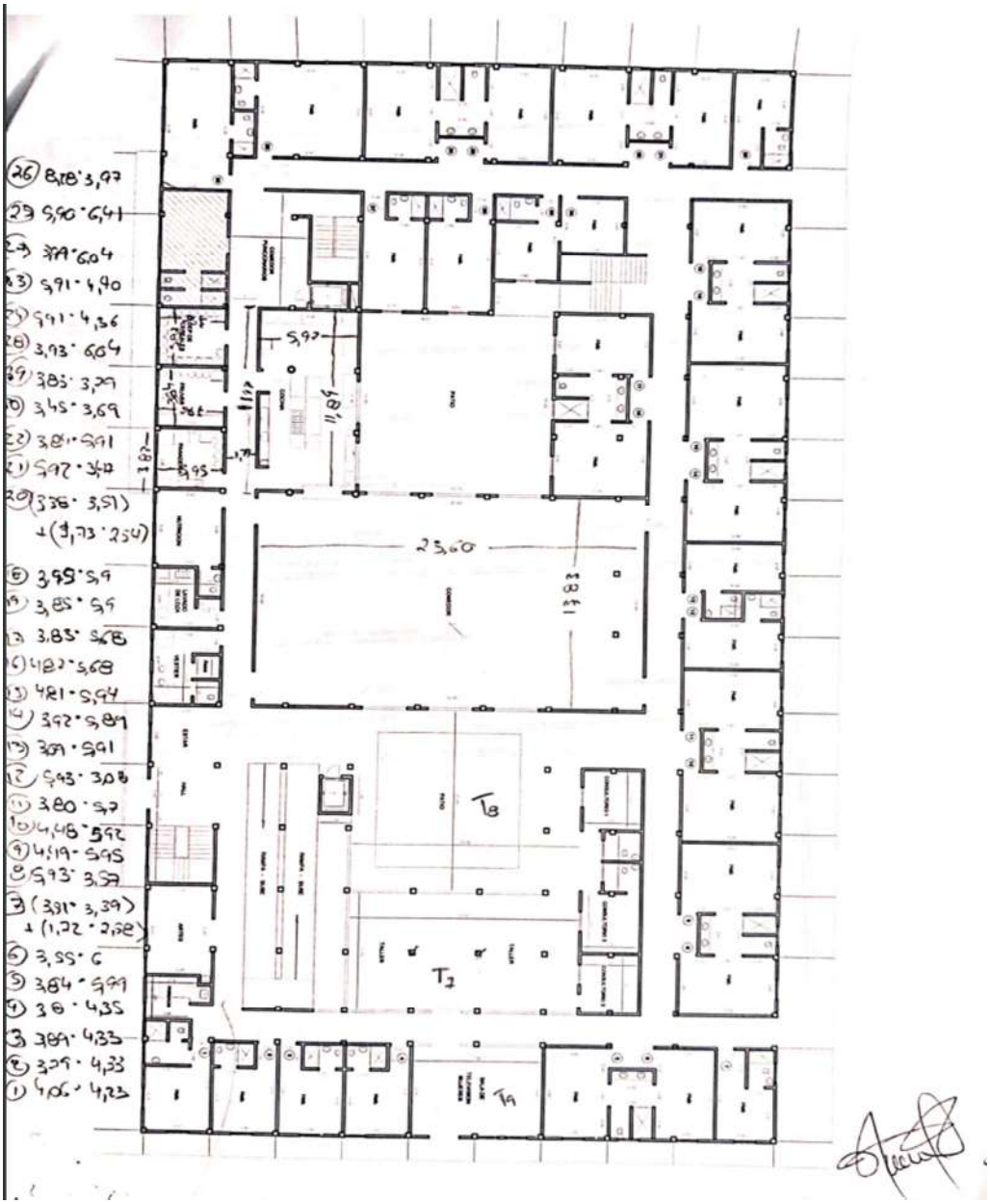
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES	IDENTIFICACION	
		PROYECTO :	7770. "COMPROMISO CON EL
		PROCESO COMPETITIVO:	SDIS-DCT-092-004-2021
		NOMBRE PROPONENTE	FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
		DIRECCION DEL PREDIO	KM 2 VÍA PASCA

PARTE IX I4. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO			
14.1. FECHA ELABORACIÓN:	3/05/2021	**14.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO:**	7770. "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE
14.3. LOCALIDAD	N/A	**14.4. CHIP**	N/A



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES	IDENTIFICACION	
		PROYECTO :	7770. "COMPROMISO CON EL
		PROCESO COMPETITIVO:	SDIS-DCT-092-004-2021
		NOMBRE PROPONENTE	FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
		DIRECCION DEL PREDIO	KM 2 VÍA PASCA

PARTE IX I4. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO			
14.1. FECHA ELABORACIÓN:	3/05/2021	**14.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO:**	7770. "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE
14.3. LOCALIDAD	N/A	**14.4. CHIP**	N/A



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SUBDIRECCION DE PLANTAS FISICAS PROCESO GESTION DE BIENES Y SERVICIOS FORMATO CALIFICACION TECNICA DE INMUEBLES	IDENTIFICACION	
		PROYECTO :	7770. "COMPROMISO CON EL
		PROCESO COMPETITIVO:	SDIS-DCT-092-004-2021
		NOMBRE PROPONENTE	FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
		DIRECCION DEL PREDIO	KM 2 VÍA PASCA

PARTE IX I4. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO			
14.1. FECHA ELABORACIÓN:	3/05/2021	**14.2. NOMBRE PREDIO O PROYECTO:**	7770. "COMPROMISO CON EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y UNA BOGOTÁ CUIDADORA E INCLUYENTE
14.3. LOCALIDAD	N/A	**14.4. CHIP**	N/A

